工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

A522002773 -採購規範書

1. 目的/用途說明：
因應「晶片驅動產業創新再升級-研發後量子晶片矽智財與核心技術分項計畫」之研發需求，本案採購品項主要用於執行後量子網路互通測試。

2. 品名：後量子網路互通測試模組

3. 產品規格(須包含下列品項)：

No.	品項	需求規格或型號	數量
1	測試運算主機板與處理器模組	CUBI 5 1M-448TW	3
2	測試平台開發模組	PI 4B 4G	5
3	測試平台鍵盤滑鼠輸入介面模組	MK240 NANO	2
4	測試平台資料儲存模組	EXTREME GO 64GB	7
5	測試平台網路資料交換模組	C1300-8T-E-2G	1
6	測試平台資料儲存模組外接傳輸介面	10G M.2	2
7	測試平台可攜式資料儲存模組	P510 2TB	2

4. 驗收標準： 交付產品之型號及數量須與「產品規格」之內容完全相符且外觀功能完好無損。

5. 付款標準： 簽約完成之次日起 30 日內全數送達指定地點，經驗收合格後支付全額款項。

6. 訓練：□有 ■無

7. 保固：■有 □無，自驗收合格之日起，由得標廠商依本案採購規範書各品項之原廠保固條件，分別提供一至三年不等之免費原廠保固與維護支援服務。

8. 服務：■有 □無

(1) 廠商需具備即時技術支援能力。

(2) 若有未詳盡事宜得標廠商得全力配合委託方進行補充。

9. 廠商交付文件：□有 ■無

10. 其他注意事項：

(1) 得標廠商得配合本院做設計變更，得標廠商不得拒絕。
(2) 交付時程若因為不可抗力因素需調整，得經主辦單位同意下進行異動。